

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2026-008

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于向金融机构申请融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》。随着公司规模不断扩大及业务量的持续增加，为满足公司项目建设、日常生产经营等需要，保证公司持续平稳运营，2026年度公司（含全资子公司及控股子公司）向金融机构申请融资，融资形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立信用证、银行承兑、资产票据池、保函等（具体业务品种以相关金融机构审批为准），在融资额度内以各金融机构与公司实际发生的融资余额为准，不超过30亿元人民币，有效期一年。如单笔融资的存续期超过了有效期，则有效期自动顺延至单笔融资终止时止。

公司董事会授权董事长或总经理按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手续，授权公司财务部门根据实际需要调配各融资主体之间的额度。

公司与合作的各金融机构皆不存在关联关系，若构成关联交易，公司将按照关联交易决策进行披露，上述交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次申请的融资额度无需提交公司股东会审议。如根据金融机构最终审批结果，融资事项涉及担保或关联交易等，将根据担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2026年3月13日